

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250822

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：半年度投资者交流电话会议
参与单位名称 及人员姓名	2025 年 8 月 22 日上午 10:30~11:30：华夏基金：高爽；嘉实基金：曲海峰；淳厚基金：曹舜卿；国联安基金：王栋；国泰海通证券：肖隽翀；国投瑞银基金：马柯；华泰保兴基金：池嘉莹；常春藤资产：程熙云；理成资产：吴圣涛；睿郡资产：刘力、董承非；圆信永丰基金：胡春霞；长城基金：杨维维、杨建华；中欧基金：郭嘉培等，共 213 名投资者及证券人员 2025 年 8 月 22 日下午 13:30~14:30：国海证券：董伯骏、孙华圳、李永磊、张新新；富国基金：毕天宇、沈衡、闫伟、孙彬、毛一凡，共 9 名投资者及证券人员
时间	2025 年 8 月 22 日上午 10:30~11:30，下午 13:30~14:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2025 年 8 月 22 日上午 10:30~11:30：董事会秘书杨平彩女士、财务总监姚红女士、投资者关系总监熊亚威先生 2025 年 8 月 22 日下午 13:30~14:30：董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下： 问 1：公司 2025 年上半年度主要经营情况如何？ 答：2025 年上半年度，公司实现营业收入 17.32 亿元，较上年同期增长 14.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元，较上年同期增长 42.78%。其中，今年第二季度：实现营业收入 9.08 亿元，环比增长 10.17%，同比增长 11.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，环比增长 20.61%，同比增长 24.79%。报告期内，公司半导体业务保持收入、利润持续增长的积极态势，同时降本控费工作持续推进，运营效率进一步提升。 问 2：公司 2025 年上半年度研发投入情况如何？ 答：公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，产品线布局广，自研孵化的创新特征明显，对应在研发方面持续有较大

投入。2025 年上半年度，公司研发投入金额 2.50 亿元，较上年同期增长 13.92%，占营业收入的比例为 14.41%，为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实的支撑，创新能力持续提升。虽然在短期内会一定程度上影响本报告期的归母净利润水平，但有助于公司各新材料项目未来陆续从孵化到产业化落地，实现企业可持续创新发展。

问 3：公司现金流及资产负债情况怎样？

答：2025 年上半年，公司现金流情况较好，经营性现金流量净额为 4.39 亿元，同比增长 28.78%，为公司各项业务的发展、投入提供了有力支持，可以支撑高端晶圆光刻胶业务、研磨粒子项目及其他新产品等研发、测试及转量产的需要。资产负债率截至 2025 年上半年末为 41.63%，较 2024 年末增加 7.55%，主要系发行可转债影响负债增加所致，随着今年第四季度可转债转股期开始，这方面带来的负债影响会稳妥下降。整体来看，公司的现金情况及负债情况是健康的，也足以支持未来可能的新项目孵化或并购、盈利项目少数股权回购等资本安排。

问 4：公司 2025 年上半年度半导体业务拓展情况如何？

答：2025 年上半年度，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计及应用业务）实现主营业务收入 9.43 亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长 48.64%，营业收入占比提升至 54.75% 水平。公司 CMP 抛光材料、半导体显示材料产品在国内主流晶圆厂、显示面板厂客户的渗透力度提升，半导体先进封装材料新品的销售起量陆续推进，驱动半导体业务整体收入增长。同时，随着量能增加带来的规模效益，以及供应链管理的持续优化、生产工艺的持续改良，半导体业务保持了较强的盈利能力，该业务的归母净利润规模同比大幅增长。

问 5：请问公司毛利率变化的原因？

答：2025 年上半年，公司半导体材料、芯片及打印复印通用耗材产品整体毛利率为 49.39%，比上年同期增加 4.08%，主要原因为：1、公司半导体业务收入在整体收入中的占比进一步增加，上半年提升至 54.75% 水平，对应高毛利产品对整体盈利能力的贡献更加凸显。2、报告期内做了大量降本控费、管理效能提升的工作，主动淘汰硒鼓、墨盒业务端低附加值产品品类和客户，在保障或提升效益的同时降低成本，从而提升了公司的盈利能力。

问 6：CMP 抛光材料产品销售情况如何？

答：2025 年上半年度，公司 CMP 抛光垫业务实现产品销售收入 4.75 亿元，同比增长 59.58%；其中今年第二季度实现产品销售收入 2.56 亿元，环比增长 16.40%，同比增长 56.64%，再创历史单季收入新高，产品月销量从第二季度开始稳定在 3 万片以上，市场渗透率持续加深，CMP 抛光垫国产龙头地位进一步稳固。公司 CMP 抛光液及清洗液业务实现产品销售收入 1.19 亿元，同比增长 55.22%；其中今年第二季度实现产品销售收入 6,340 万元，环比增长 14.88%，同比增长 56.63%；报告期内，公司铜制程抛光液成功实现首次订单突破，其他在售 CMP 抛光液型号稳定上量，在测品类加速验证、导入，同时自产研磨粒子的供应链优势凸显。

问 7：潜江 CMP 抛光垫工厂情况怎样？

答：潜江 CMP 抛光垫工厂在上半年继续保持盈利。从产品端来看，CMP 抛光软垫补充了晶圆厂客户 CMP 精抛的需求，对于产品型号的补全很重要，同时缓冲垫为 CMP 抛光硬垫供应链安全带来保障，这一块在持续稳定放量供应。同时，公司开拓了国内主流大硅片和碳化硅客户精抛软垫订单，为未来 CMP 抛光垫业务业绩增长开发出新的方向。

问 8：CMP 抛光液、清洗液业务的盈利情况如何？

答：公司 CMP 抛光液、清洗液，及 CMP 抛光液用配套研磨粒子在武汉、仙桃园区的投入较大，产品品类多，因此在放量早期阶段各方面的费用都较高，收入及利润爬坡有其自身的行业节奏。随着未来该业务的收入规模逐步增加，规模边际效应会得到提升，有望成为公司利润来源的又一个重要补充。

问 9：公司显示材料的业务进展怎么样？

答：2025 年上半年度，公司半导体显示材料业务方面实现产品销售收入 2.71 亿元，同比增长 61.90%；其中今年第二季度实现产品销售收入 1.41 亿元，环比增长 7.82%，同比增长 44.75%。YPI、PSPI 产品的市场占有率进一步提升，TFE-INK 产品持续进行市场突破，下半年出货量有望进一步增加。此外，公司仙桃产业园年产 800 吨 YPI 二期项目已经开始试运行，为下半年销售持续放量做好产能储备。

问 10：公司高端晶圆光刻胶业务的新品开发进度如何？

答：2025 年上半年，公司浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶业务持续推进，已布局近 30 款高端晶圆光刻胶，超过 15 款产品已送样给客户验证，其中超过 10 款进入加仑样测试阶段，整体测试进展顺利，其中有数款产品有望在今年下半年全力冲刺订单。

问 11：公司潜江晶圆光刻胶二期项目建设进展如何？

答：公司二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线建设的整体进展顺利，主体设备基本安装完毕，正在进行工艺管件、阀门等和自控系统的安装，计划今年第四季度转入试生产的状态，符合公司年初的预期。二期量产线具备高度自动化和信息化的特点，以全面保障未来量产的稳定性。

问 12：公司先进封装材料业务的进展如何？

答：公司半导体封装 PI、临时键合胶产品在下游客户测试的进展还是比较顺利的，在售型号数量及覆盖客户数量进一步增加。下半年在晶圆厂客户、封测厂客户的市场推广都在正常进行，下半年放量进度有望较上半年加快。

问 13：公司打印复印通用耗材上半年经营情况如何？

答：2025 年上半年度，公司打印复印通用耗材业务实现营业收入 7.79 亿元（不含通用耗材芯片），同比下降 10.12%；归母净利润水平亦受终端市场需求影响，同比有所下滑。公司耗材业务以利润目标为核心导向，坚定

	地推进降本控费与提质增效等专项工作，推行人效提升各项举措，持续关注风险管控并减少风险损失，全力保障传统耗材业务的稳健经营。 问 14：耗材业务有哪些经营优化的举措？ 答：公司在打印复印通用耗材业务端是以利润优先，而不是以营收规模驱动，所以在终端硒鼓、墨盒产品上，主动做了一些产品型号及客户的调整，放弃了一些低毛利的客户和产品品类，部分影响到耗材业务整体收入的下滑，但对耗材业务经营效率的提升有利。
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 22 日